**보도자료 문의**

Mike Dunne

Mike.Dunne@samtec.com

 812-944-6733

****

**삼텍, 픽-앤-플레이스 공정을 용이하게 하는**

**75Ω 고밀도 BNC 제품 출시**

낮은 높이에 무게 균형을 이루도록 한 고유의 라이트 앵글(right-angle) 디자인

**2022년 3월— 삼텍(**Samtec)은 고유의 오른쪽 앵글 디자인을 사용해서 대량 제조를 위한 픽-앤-플레이스 공정을 용이하게 하는 75Ω 고밀도 BNC 솔루션(HDBNC 시리즈)을 출시한다고 밝혔다(-BM1D 및 -BM2D 다이 캐스트 옵션).

첨단 방송 비디오 장비에 사용하기에 적합하도록 설계된 삼텍의 HDBNC 시리즈는 새로운 SMPTE 2082 12G-SDI 요건에 대한 시험을 통과했으며, 리턴 손실 측정이 0~12GHz로 최소 요건을 적어도 -10dB 이상 상회해서 충족한다. VSWR과 삽입 손실 또한 극히 낮다. 전체적인 제품 사양 및 특성분석 보고서는 [samtec.com?HDBNC-BM](https://www.samtec.com/products/hdbnc-bm)에서 볼 수 있다.

이들 제품은 디자인을 최적화해서 표면적을 늘림으로써 진공 실링을 용이하게 하고, 무게중심을 수정해서 PCB 상으로 픽-앤-플레이스 공정을 할 때 무게 균형을 이루도록 한다. 또한 HDBNC-BM1D와 HDBNC-BM2D 다이 캐스트 제품은 8mm 바디 높이에 8.5mm 폭으로 컴팩트한 디자인으로 패널 밀도를 높이도록 한다. 바디 높이가 기존에 출시된 스크류 형태 라이트 앵글(screw-machined right angle) HDBNC 시리즈와 일치하므로 기존 애플리케이션을 손쉽게 교체할 수 있다.

이 외에도 삼텍은 방송 비디오 시스템 용으로 다양한 구성의 제품 포트폴리오를 제공한다. [samtec.com/12gsdi](https://www.samtec.com/standards/12gsdi)에서 이들 제품에 관한 더 자세한 정보를 볼 수 있다. 또한 삼텍의 RF/신호 무결성 엔지니어들이 특정 애플리케이션을 위한 제품 설계, 75Ω 신호 무결성 지원, 고객 보드 설계 서비스 같은 지원을 제공한다. 이에 관해서는 [RFGroup@samtec.com](http://RFGroup@samtec.com)으로 문의할 수 있다.

**삼텍(Samtec, Inc.) 회사 소개**

1976년에 설립된 삼텍은 고속 보드간(board-to-board), 고속 케이블, 미드 보드 및 패널 광학, 정밀 RF, 유연한 스태킹 및 마이크로/러기드 부품 및 케이블을 포함한 다양한 전자 인터커넥트 솔루션 라인을 제공하는 9억5000만달러 규모의 비상장 제조기업이다.

삼텍 테크놀로지 센터는 베어 다이에서 100미터 떨어진 인터페이스까지, 그리고 그 사이의 모든 인터커넥트 지점에 이르는 시스템의 성능과 비용 두 가지를 모두를 최적화시키는 기술, 전략, 제품을 개발 및 최첨단화 하는데 전념하고 있다. 삼텍은 전세계 40여곳의 지사 운영과 125개국에서의 제품 판매를 통해 뛰어난 고객 서비스를 실천하며 글로벌 시장에서의 입지를 다지고 있다.

상세 정보는 <http://www.samtec.com>참조.